

議事録

7-31BV

Automotive Addendum Task Group Meeting

Tuesday, February 27 / 10:15 to 5:00 PM

2018 IPC Spring Committee Meetings

1. 議長挨拶
2. 参加者自己紹介
3. 参加者名簿確認
4. 関連ドキュメントのレビュー
 - a. アンチトラストドキュメント
 - b. 標準化方針
 - c. IPC (特許)権利ポリシー
5. 許容基準であるIPC-A-610と工程管理要件であるJ-STD-001の組み合わせによる自動車産業向け追加要件：下記項目についての議論を実施
6. 前回ミーティングでのアクションアイテムを確認
 - a. 2017年6月27日ミーティングより (プリマス、USA)
 - 極薄膜コーティングについて: T氏により2018年8月末までにデータ提出。D氏が、2018年10月18日に行われる秋季大会に参加予定。
 - 受動素子の新しい電極タイプについて： ドラフトの提示(C社)
 - 平坦化されたガルウイングはんだ接合部におけるフィレット基準
 - チップ部品のビルボーディング(ツームストーン現象)
 - チップ部品のフィレット高さ
 - 電解コンデンサの許容条件
 - フラットラグリード
 - エアギャップ対クリープエイジパス(沿面経路)における電氣的クリアランス
 - 隠れたはんだ接合部の基準 (LGAs, プルバックQFNs, マルチロウQFNsなど)
 - 濡れの可能なフランクQFNs
 - はんだ破片の存在による影響
 - サイベースコーティング

- b. プロダクトロニカ 2017 ミーティングより
 - 第 10 章 コンフォーマルコーティングについて
 - はんだ接合部におけるシャンパンボイド関連
 - BTC と BGA の X/Y 熱膨張率関連
 - 車載グレードでない部品の使用について
 - 車載組立品への設計ガイドライン
 - ESD の要件範囲
 - 汚染について
 - 技術的な清浄性
 - はんだボールのサイズ制限
 - コールドジョイントグループとの連携: プレスフィット関連の許容基準をどう取り扱うか
 - リードレス部品における曲げ要件
 - スルーホールコネクタ、はんだ付の出来ないリードの要件
 - リードの突起: 完

- 7. 主要な車載向け追加要件に関する情報特定・収集・確認
 - a. IPC-A-610への変更を促すもの
 - b. IPC-A-610の追加として使用すべきもの
 電子組立品が、確実に自動車顧客の要求を満たすこと
 トピックス (推奨):
 - 新部品
 - ワイヤーボンディング
など

- 8. ボイドがはんだ接合部の信頼性に及ぼす影響についてのデータ収集とレビュー:
 - a. チップ部品: NexteerとFlextronicsにより、チップ部品の(温度サイクル)信頼性における調査データが共有された。予備評価では、温度サイクル信頼性ではボイドの影響は限られている。より詳細な調査内容をSMTAI 2018にて発表

- 9. プレスフィット接続における許容基準 – 秋季大会にて提案予定

- 10. 次回ミーティング予定
 - 2018年6月7日 @ smt hybrid packaging
 - 2018年10月 IPC 秋季委員会 @ SMTAI 2018